4-2 深紫外光デバイス研究開発

4-2 Research and Development on Deep-ultraviolet Optical Devices

4-2-1 深紫外固体光源デバイス技術の研究開発

4-2-1 Research and Development of Deep-ultraviolet Light-emitting Diodes

井上振一郎

INOUE Shin-ichiro

波長が 280 nm よりも短い UV-C 光を発する深紫外発光ダイオード (DUV-LED) は、情報通信か ら殺菌、光加工、医療応用に至るまで、幅広い分野においてその重要性が増しており、社会普及 への期待が高まっている。近年、AlGaN 系深紫外 LED デバイスの結晶品質や内部量子効率は大幅 に向上してきている。しかしながら、その光出力については、従来の深紫外光源である水銀ラン プと比較すると、いまだ低い値にとどまっている。一方で、水銀ランプは人体や環境に有害な水 銀を含み、大型で環境負荷の高い製品であるため、水銀廃絶に向けた「水銀に関する水俣条約」 (2017 年発効) 等において、その代替が強く求められている。この状況を打破するため、筆者らは、 内部光吸収や光出力飽和現象 (効率ドループ) の抑制を可能とするナノ光構造技術を基盤とした深 紫外 LED の研究を行ってきた。本稿では、単チップにおいて光出力 500 mW を超える、水銀ラン プに迫る極めて高出力な 265 nm 帯深紫外 LED を世界で初めて実証した取組などについて紹介す る。

Deep-ultraviolet (DUV) light-emitting diodes (LEDs) with UV-C emission wavelengths shorter than 280 nm have huge potential for a wide range of applications, including surface disinfection, air/ water purification, medical diagnostics, lithographic microfabrication, and ICT. Rapid progress has been made recently in the development of AlGaN-based DUV-LEDs. However, DUV-LEDs continue to have much lower output power than traditional mercury vapor lamps. Meanwhile, these lamps are bulky and contain mercury, which is harmful to humans and has a high environmental impact. Today, there is a pressing need to develop alternatives to mercury under the Minamata Convention on Mercury which entered into force in 2017. To solve these problems, we have studied DUV-LEDs with nanophotonic structures to significantly reduce the internal optical absorption and efficiency droop. In this paper, we show the high-power single-chip 265 nm DUV-LEDs with output power in excess of 500 mW, bringing substantial advantages over conventional mercury vapor lamps.



波長が280 nmよりも短いUV-C領域の光を発する 深紫外(Deep-Ultraviolet: DUV)発光ダイオード (Light-Emitting Diode: LED)は、実現可能な半導体 LEDとして、最も波長が短い。このため青色LEDに 続く研究フロンティアとして、世界中の多くの研究機 関において活発に研究開発が進められている[1]-[6]。 また、このUV-C領域の光は、大気中のオゾン層で全 て吸収されるため、自然界には存在せず(地表の太陽 光の中に含まれない)、ソーラーブラインド領域と呼 ばれる。このため、太陽光の背景ノイズの影響を受け ない通信やセンシングが原理上可能となる。さらに深 紫外光は、空気中を伝搬できる光の中で最も波長が短 い。このため可視・赤外光と比較し、大気中に漂うエ アロゾル等の微粒子に対して高い散乱係数を有する。 これらの深紫外光の特殊な性質を利用することで、ビ ルなどの障害物がある見通しが悪い状況下でも通信を 可能とする、見通し外 (Non Line of Sight: NLOS) 光空 間通信への応用が期待されている [7][8]。また、UV-C 光の存在しない自然環境下で進化してきた生物の DNA は、UV-C 領域の中に強い吸収構造を持ち、深紫 外LEDを使えば、塩素などの薬剤を用いずに、有害 な細菌やウィルスなどを効果的に殺菌(不活性化)でき る。中でも特に、波長265 nm帯の深紫外LEDは、発 光波長がDNAの吸収ピークと重なり最も強い光殺菌 作用を有することから[9]、ウィルス感染予防や水の浄 化などの殺菌用途において重要な開発ターゲットと なっている。また通信や殺菌用途以外にも深紫外LED は、光加工・3Dプリンタの高精細化や樹脂の硬化、印 刷、環境汚染物質の分解、分光分析、医療応用など、多 様な技術領域において今後重要な役割を果たしていく ものと期待されている。

従来、深紫外光を照射する光源として、産業的には 主に水銀ランプが用いられてきた。水銀ランプは高出 力かつ安価であるため現在も広く利用されているが、 人体や環境に有害な水銀を含み環境負荷の高い製品で ある。2017年、水銀廃絶に向け「水銀に関する水俣条 約」が発効し、2020年より、水銀を含む製品の製造や 輸出入について段階的な制限規制が始まっている。こ のため、水銀ランプに代わる小型・低環境負荷固体光 源として深紫外 LED への期待が飛躍的に高まってい る(図1)。しかしながらこれまで、光出力とコストの 両面で水銀ランプに圧倒的な優位性があり、本格的に 代替が進むような状況には至っていない。今後、情報 通信応用から殺菌、光加工、水銀ランプ代替といった UV-C 高出力ニーズに、コストを抑えつつ対応してい くためには、深紫外 LED の単チップ当たりの光出力 をいかに高めていくかが最重要課題の一つとなる。本 稿では、深紫外 LED の高出力化を阻んでいる幾つか の要因について述べたうえで、独自のナノ光構造技術 に立脚し、単チップで小型低圧水銀ランプに迫る光出 力 500 mW 超(世界最高出力)の 265 nm 帯深紫外 LED の実証に成功した研究成果を中心に紹介する。

2) 深紫外 LED の技術課題

2.1 高密度な結晶欠陥生成

深紫外 LED は、窒化アルミニウムガリウム(AlGaN) から構成される。窒化アルミニウム (AIN) と窒化ガリ ウム (GaN) の混晶組成比を変えることで、その発光波 長を広範囲(210~365 nm)で任意に制御でき、深紫外 のほぼ全域をカバーする。AlGaN 系深紫外 LED は 通常、有機金属気相成長(Metal Organic Chemical Vapor Deposition: MOCVD) 法を用いてサファイア基 板上に形成される。しかし従来、AlGaN 層とサファイ ア基板との格子定数差に起因し、結晶内部に10° cm-2 以上という非常に高密度な結晶欠陥(貫通転位)が発生 し、素子の性能が大きく低下してしまう問題を長らく 抱えていた(図 2(a))。この課題に対し、 $10^7 \sim 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 程度まで貫通転位を低減するパターン形成されたサ ファイア基板上の結晶成長技術や[10]、貫通転位がほ ぼ発生しない(< 10⁶ cm⁻²) AIN 基板上 LED 形成技術等 が[11][12]、近年多数報告されている。これらの結晶品 質の向上によって、結晶内部の発光効率については大 幅に改善されてきている。最近、我々は電流注入時の 内部量子効率 (Internal Quantum Efficiency: IQE) や キャリア注入効率 (Carrier Injection Efficiency: CIE) の値を定量化する新しい技術を開発し、連続駆動中の 265 nm 帯 AIN 基板上深紫外 LED の IQE が 78 % とい



図 1 深紫外波長領域の従来光源と深紫外 LED の必要性



図 2 (a) 深紫外 LED 技術課題の模式図、(b) 本研究で用いたナノ光構造付加型深紫外 LED デバイス構造の模式図と (c) その電子顕微鏡写真

う、青色 LED に匹敵する極めて高い値にまで達して いることを報告している [13]。

2.2 p-AlGaN 中の深いアクセプター準位

しかし、これらの近年の研究進展により結晶品質に 係る問題が大きく改善された一方で、依然として深紫 外 LED の高出力化を阻んでいる幾つかの重大な課題 が残されている。まず、265 nm 帯のような Al 組成比 の高い AlGaN 系深紫外 LED では、p 型層として形成 される p-AlGaN 中のアクセプター準位 (ドーパント: Mg)が非常に深くなる [14]。一般に、Al 組成比率 70 % 程度において、その活性化エネルギーは400 meV 前後 にもなる[15]。このため室温でのホール濃度が極めて 低く、p 側金属電極との間の低抵抗なオーミック接合 を得ることが難しい。この問題を避けるために、 p-AlGaN 上に、高ホール濃度の p-GaN 層を p 電極との 間のコンタクト層として形成することが一般的である。 しかし p-GaN はオーミック接合を可能とする一方で、 深紫外光を完全に吸収する。つまり、このような 265 nm 帯深紫外 LED では、活性層から放射された光 のうちp電極方向に放射された約半分の光は、ほとん ど全て吸収され損失となる。また、可視光 LED と異 なり深紫外領域では、ITO (Indium-Tin Oxide) のよう な効率よく電流拡散を行える透明電極も存在しない。 このため、深紫外 LED では必然的に、発光した光を 基板側から取り出すフリップチップ実装と呼ばれる配 置をとる。

2.3 極めて低い光取出し効率

深紫外 LED では、深紫外光によって樹脂が劣化す るため、可視光 LED のような透明・半球状の樹脂封 止技術の利用は難しい。このため、基板と空気との界 面で大きな屈折率差による全反射が生じ、光を取り出 せる角度領域が狭い。さらに深紫外 LED では一般的 に、p-GaN や電極などによる内部吸収が大きいため、 基板界面で全反射された光を再度デバイス裏面から折 り返して取り出すマルチパスの利用も難しい。特に、 AIN 基板は屈折率が高く (n=2.29 @265 nm)、光取出 し角度が狭い(臨界角:25.9°)うえに、基板自体が深紫 外光をある程度吸収する性質を持つため、この問題は より深刻となる。ハイドライド気相成長法で作製した 比較的透明度の高い AIN 基板を用いても、265 nm 帯 では 10 cm⁻¹ 程度の吸収係数を有する[16]。3 次元時間 領域有限差分(Finite-Difference Time-Domain: FDTD) 法により計算を行うと、AIN 基板上深紫外 LED の光 取出し効率(Light Extract Efficiency: LEE)は、僅か 3 %程度と極めて低い。これらの原因によって、せっ かく転位欠陥密度を下げて高い内部量子効率が得られ ても、活性層で発せられた光のほとんどは、外部に取 り出される前に結晶内部で再吸収され、熱として失活 してしまう。このジレンマの克服が深紫外 LED の最 大の課題である。

2.4 光出力飽和現象(効率ドループ)

265 nm帯 AlGaN 系深紫外 LED では、透明性を維 持するために、電流を注入するためのクラッド層の Al の組成比率が70%程度以上と極めて高くなるため、 p型n型どちらも電気抵抗率が高くなる。このため、 p電極とn電極の間の距離が最も短くなる電極メサ構 造のエッジ近傍に電流が集中しやすく、印加電流の増 加に伴い電流密度が非常に高くなる問題が発生す る[17][18]。またさらに前述のとおり、LEE が極めて低 いため、その印加電力の大部分が、素子内部で局所的 に熱に変換されてしまう。この結果、注入電流の増加 に伴って LED 活性層温度の急激な上昇(自己発熱)と、 量子効率の低下が起こり、従来の可視や近紫外の LED と比べ、光出力が極めて早く飽和してしまう現象(ド ループ)が生じる。高出力化を実現するうえでは深刻 な課題である。

3 高出力深紫外 LED の開発

3.1 ナノ光構造を駆使した高光取出し技術

一般に、半導体のバンドギャップの大きさとドーパント制御による電気的伝導性(及び n/p 型両極性)とは相反する性質となる。短波長化や透明性を優先すれば、

4 環境制御 ICT 基盤技術 ――基盤から社会展開まで―

トレードオフで導電性に不利が生じる。また、AIN 基 板を用いて格子定数差の解消、貫通転位密度の低減を 優先すれば、光取出し特性の面で大きな問題を抱えて しまう。よって、深紫外 LED においては選択する材 料的なアプローチとともに、その裏側に発現する物性 的弱点をデバイス構造としてどう補完していくのかと いう総合的なデザインが求められる。本研究では、最 も殺菌性の高い 265 nm 帯の光を発し、高出力で高安 定電流駆動の深紫外 LED を実現するため、素子内に AIN 基板や p-GaN コンタクト層などの光吸収媒質が含 まれていても、活性層から放射された深紫外光を、シ ングルパスで吸収される前に素子外部に効果的に取出 せる手法の創出を目指した。

我々は IQE を高められる AIN 基板上 LED 構造を用 いて、光取出し面となる AIN 基板表面に、全反射を抑 制する AIN ナノ光構造を組込んだ深紫外 LED を開発 した(図2(b))。ナノ光構造として、フォトニック結 晶と呼ばれる波長スケールの2次元周期凹凸構造と、 波長の1/10 程度のサイズのサブ波長テクスチャ構造 を組み合わせた、全く新たなハイブリッド構造を設計 した。

作製したハイブリッド型 AIN ナノ光構造の電子顕 微鏡写真を図2(c)に示す。このハイブリッド型ナノ光 構造では、波長スケールのフォトニック結晶構造によ り深紫外域の光分散を人為的に制御すると同時に、サ ブ波長テクスチャ構造により界面全反射時のエバネッ セント光の生成とその界面導波特性を制御した。図3 に光伝播の様子を計算した結果を示す。サブ波長テク スチャ構造の近傍で生成されたエバネッセント光は、 最適に設計された AIN コーンの側面を昇るように導 波していき、その頂点で高効率に外部伝搬モードと カップリングする様子が見て取れる。これらの極めて ユニークな原理によって、本来、全反射され内部吸収 されてしまう光成分の多くを、外部に取り出すことが できる。

光取出しに関する効果を評価した結果を図4に示す。 従来素子(表面加工無し)と比較し、光取出し効率が、 約2倍と大幅に向上した。これは、最適化されたフォ トニック結晶構造単体はもとより、表面ラフニング構 造や、マイクロレンズ構造、モスアイ(蛾の眼)構造な ど、従来提案されてきた種々の光取出し構造よりも、 40~50%以上も高い結果である[5]。

3.2 ナノ構造付加型発光デバイスの大面積化・ 高スループット化技術

265 nm 帯 AlGaN 系深紫外 LED では、先に述べた とおり印加電流の増加に伴い光出力が極めて早く飽和 してしまうドループ現象が生じる。このため、高出力



図 3 ハイブリッド型 AIN ナノ光構造周辺の電場分布 (波長 265 nm) の計算結果 (a) 計算構造モデル、(b) 電場分布



図 4 265 nm 帯深紫外 LED の AIN ナノ光構造付加による光取出し向上率

化を実現するうえでは、高電流注入時の電流密度を低 減するため、実効発光面積の拡大に取り組むことも重 要である。まず、深紫外 LED デバイス内の局所電流 集中の問題に対して、我々は電流拡散や自己発熱特性 について電流 - 熱連成計算解析を行い、大面積化した 場合でもエッジ近傍に電流が集中せず、発光層への均 ーな電流拡散を可能とする電極メサ構造を設計し た[19]。次に、発光領域の増大に伴い、光取出し効率 を向上させる AIN 基板上のナノ光取出し構造につい ても大面積化することが必要となる。これまでの研究 ではナノサイズ加工に対し、精度や設計柔軟性の面か ら電子ビーム (EB) 描画技術を用いていたが、LED の ような低コスト化が何よりも重視されるプロセスには 不向きである。そこで本研究では、将来の産業応用を 見据え、EB 描画ではなく大面積・高スループット加 工・低コスト化が実現可能なナノインプリント技術を 用いて作製した。AINのような加工の難しい材料を用 いてナノ構造を駆使した光出力の向上を目指しながら、 低コスト化への適応性も並行して検討した。開発した 作製技術の詳細は、参考文献[20]を参照いただきたい。

3.3 265 nm 帯深紫外 LED の高出力化実証

ナノインプリント技術を用いて形成した AIN ナノ 光構造付加型深紫外 LED (チップ面積:約1 mm²、メ サ面積: 0.35 mm²)をTOパッケージにフリップチッ プ実装した外観写真を図5に示す。光の干渉を起こす AIN ナノ光構造が、チップ全面にむらなく均一に形成 されているのが分かる。同素子の光出力特性を図6に 示す。従来素子(表面加工無し)では、注入電流の増加 に伴い、急速に光出力が飽和してしまう現象(ドルー プ)が見られた。一方、AIN ナノ光構造を形成した深 紫外 LED では、光出力が増大するとともに、注入電 流を増加させても、ドループの発生が抑制された。こ の結果、従来素子に対し、高電流値において約20倍 (@850 mA)もの大幅な出力向上が得られた[20]。ナノ 光構造の効果を検証するため、図7に両素子の遠視野 及び近視野像を示す。どちらのプロファイルにおいて も、従来素子に対しナノ光構造を付加した深紫外LED では、高強度かつより広い角度範囲で深紫外光放射が 観測された。開発した AIN ナノ光構造により、光取出 し角度が大幅に拡大されていることを明確に示す実験



図5 AIN サブマウントへのフリップチップ接合後の深紫外 LED の外観



図6 開発した深紫外 LED の注入電流に対する光出力とエンハンスメント



図7 (a) 従来型 (表面加工無し) と (b) AlN ナノ光構造付加型の遠視野像比較、(c) 従来型 (表面加工無し) と (d) AlN ナノ光構造付加型の近視野像比較



図8 面積を拡大したナノ光構造付加型深紫外 LED の注入電流に対する光 出力。挿入図は1A時の EL スペクトル



図 9 実装後、電流を印加し発光中の深紫外 LED の外観写真

結果である。最後に、LED チップ及び AIN ナノ光取 出し構造の面積を 1.8 × 1.8 mm²に拡大したデバイス の光出力特性を図 8 に示す。発光領域を拡大しドルー プを更に抑制することで、発光波長 265 nm、シングル チップ、室温・連続駆動下の深紫外 LED において (図 9)、光出力 520 mW 超という小型低圧水銀ランプ に匹敵する特性が得られた。

4 今後の展望とまとめ

環境にやさしく、小型・ポータブルで高出力な深紫 外LEDの実現は、水銀ランプの置き換えだけではな く、持ち運び可能なウィルス殺菌システムやポイント オブケア型医療、家電搭載など、これまでにない小型 DUV 光源の特色を活かした様々な新しい応用分野の 開拓が期待される。本稿で取り上げた単チップでの 265 nm 帯深紫外 LED の高出力動作実証は、それらの 普及へ鍵となる光源の高出力化と低コスト化、両面に 対して大きく貢献する技術である。

また一方で、深紫外 LED には外部量子効率 (External Quantum Efficiency: EQE) や長期信頼性など、い まだ改善すべき点が多いことも付記しておく。我々は 265 nm 帯深紫外 LED の EQE として最も高い 6.3 % を 報告している [5]。また、より長波長 (より低 Al 組成) の 275 ~ 280 nm 帯の深紫外 LED では、p-GaN を使わ ず p-AlGaN に直接コンタクトを取ることで、比較的低 出力であるものの 10 ~ 20 % 程度の EQE も最近報告 されている [21][22]。2000 年代前半まで UV-C 領域の EQEが0.5%未満程度であったことを考えれば大きく 進展しているものの、80%超のEQEも実現されてい る青色 LED の効率 [23] と比較するといまだ低い値に とどまっている。今後、新しいコンタクト材料の開 発[24] やナノ光構造を用いた DUV 光制御技術の更な る発展はもちろん、周囲のパッケージ構造まで含めた 新たな工夫の導入を考えている。発光波長が最も短く、 あらゆる箇所での光吸収、自己発熱や経時劣化が生じ やすい深紫外 LED においては、それらの課題に総合 的に対処し、性能だけではなく信頼性まで含めた議論 を積み重ねて進展していくことが重要である。

今後は、深紫外 LED だけでなく深紫外レーザーダ イオード(LD)も含め、水銀フリーかつ小型・高出力・ 高効率、長寿命な深紫外固体光源システムの研究開発 を更に発展させ、その社会実装を実現していくととも に、これまでになかったソーラーブラインドな特徴を 活かした様々な新しい DUV-ICT の開発可能性を世界 に先駆け実証していくことで、安心・安全でクリーン、 持続可能な社会の構築に貢献することを目指していく。

謝辞

本稿で紹介した研究は、深紫外光 ICT デバイス先端 開発センターのメンバーの協力及び株式会社トクヤマ 並びにスタンレー電気株式会社との共同研究の下、実 施されたものである。また本研究は、科学技術振興機 構 (JST)の研究成果展開事業 A-STEP (AS2525010 J、 AS2715025 R)からの支援の下に遂行された。協力い ただいた関係者の皆様にこの場を借りて深く感謝申し 上げる。

【参考文献】

- 1 A. Khan, K. Balakrishnan, and T. Katona, "Ultraviolet light-emitting diodes based on group three nitrides," Nat. photon., vol.2, pp.77, 2008.
- 2 M. Kneissl, T. Y. Seong, J. Han, and H. Amano, "The emergence and prospects of deep-ultraviolet light-emitting diode technologies," Nat. photon., vol.13, p.233, 2019.

- 3 M. Shatalov, W. Sun, R. Jain, A. Lunev, X. Hu, A. Dobrinsky, Y. Bilenko, J. Yang, G. A. Garrett, L. E. Rodak, M. Wraback, M. Shur, and R. Gaska, "High power AlGaN ultraviolet light emitters," Semicond. Sci. Technol., vol.29, 084007, 2014.
- 4 M. Kneissl and J. Rass, "A Brief Review of III-Nitride UV Emitter Technologies and Their Applications," III-Nitride Ultraviolet Emitters Technology and Applications, Springer, 2016.
- 5 S. Inoue, N. Tamari, T. Kinoshita. T. Obata, and H. Yanagi, "Light extraction enhancement of 265 nm deep-ultraviolet light-emitting diodes with over 90 mW output power via an AIN hybrid nanostructure," Appl. Phys. Lett., vol.106, 131104, 2015.
- 6 井上振一郎, "ナノ光構造技術を用いた高出力深紫外 LED" 応用物理, vol.88, no.10, pp.663-667, 2019.
- 7 G. Chen, Z. Xu, and B. M. Sadler, "Experimental demonstration of ultraviolet pulse broadening in short-range non-line-of-sight communication channels," Opt. Express, vol.18, 10500, 2010.
- 8 G. Chen, Z. Xu, H. Ding, and B. M. Sadler, "Path loss modeling and performance trade-off study for short-range non-line-of-sight ultraviolet communications," Opt. Express, vol.17, 3929, 2009.
- 9 M. Kneissl, T. Kolbe, C. Chua, V. Kueller, N. Lobo, J. Stellnach, A. Knauer, H. Rodriguez, S. Einfeldt, Z. Yang, N. M. Johnson, and M. Weyers, "Advances in group III-nitride-based deep UV light-emitting diode technology," Semicond. Sci. Technol., vol.26, 014036, 2011.
- 10 M. Kim, T. Fujita, S. Fukahori, T. Inazu, C. Pernot, Y. Nagasawa, A. Hirano, M. Ippommatsu, M. Iwaya, T. Takeuchi, S. Kamiyama, M. Yamaguchi, Y. Honda, H. Amano, and I. Akasaki, "AlGaN-Based Deep Ultraviolet Light-Emitting Diodes Fabricated on Patterned Sapphire Substrates," Appl. Phys. Express, vol.4, 092102, 2011.
- 11 J. R. Grandusky, J. Chen, S. R. Gibb, M. C. Mendrick, C. G. Moe, L. Rodak, G. A. Garrett, M. Wraback, and L. J. Schowalter, "270 nm Pseudomorphic Ultraviolet Light-Emitting Diodes with Over 60 mW Continuous Wave Output Power," Appl. Phys. Express, vol.6, 032101, 2013.
- 12 T. Kinoshita, T. Obata, T. Nagashima, H. Yanagi, B. Moody, S. Mita, S. Inoue, Y. Kumagai, A. Koukitu, and Z. Sitar, "Performance and Reliability of Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes Fabricated on AIN Substrates Prepared by Hydride Vapor Phase Epitaxy," Appl. Phys. Express, vol.6, 092103, 2013.
- 13 G.-D. Hao, N. Tamari, T. Obata, T. Kinoshita, and S. Inoue, "Electrical determination of current injection and internal quantum efficiencies in AlGaN-based deep-ultraviolet light-emitting diodes," Opt. Express, vol.25, A639, 2017.
- 14 M. L. Nakarmi, N. Nepal, J. Y. Lin, and H. X. Jiang, "Photoluminescence studies of impurity transitions in Mg-doped AlGaN alloys," Appl. Phys. Lett., vol.94, 091903, 2009.
- 15 M. L. Nakarmi, K. H. Kim, M. Khizar, Z. Y. Fan, J. Y. Lin, and H. X. Jiang, "Electrical and optical properties of Mg-doped Al_{0.7} Ga_{0.3} N alloys," Appl. Phys. Lett., vol.86, 092108, 2005.
- 16 12. T. Kinoshita, K. Hironaka, T. Obata, T. Nagashima, R. Dalmau, R. Schlesser, B. Moody, J. Xie, S. Inoue, Y. Kumagai, A. Koukitu, and Z. Sitar, "Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes Fabricated on AIN Substrates Prepared by Hydride Vapor Phase Epitaxy," Appl. Phys. Express, vol.5, 122101, 2012.
- 17 W. Sun, M. Shatalov, J. Deng, X. Hu, J. Yang, A. Lunev, Y. Bilenko, M. Shur, and R. Gaska, "Efficiency droop in 245–247 nm AlGaN lightemitting diodes with continuous wave 2 mW output power," Appl. Phys. Lett., vol.96, 061102, 2010.
- 18 G.-D. Hao, M. Taniguchi, N. Tamari, and S. Inoue, "Enhanced wall-plug efficiency in AlGaN-based deep-ultraviolet light-emitting diodes with uniform current spreading p-electrode structures," J. Phys. D, Appl. Phys., vol.49, 235101, 2016.
- 19 G.-D. Hao, M. Taniguchi, N. Tamari, and S. Inoue, "Current crowding and self-heating effects in AlGaN-based flip-chip deepultraviolet lightemitting diodes," J. Phys. D: Appl. Phys., vol.51, 035103, 2018.
- 20 S. Inoue, N. Tamari, and M. Taniguchi, "150 mW deep-ultraviolet lightemitting diodes with large-area AIN nanophotonic light-extraction structure emitting at 265 nm," Appl. Phys. Lett., vol.110, 141106, 2017.
- 21 M. Shatalov, W. Sun, R. Jain, A. Lunev, X. Hu, A. Dobrinsky, Y. Bilenko, J. Yang, M. Shur, R. Gaska, C. Moe, G. Garrett, and M. Wraback, "AlGaN Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes with External Quantum Efficiency above 10%," Appl. Phys. Express, vol.5, 082101, 2012.

- 22 T. Takano, T. Mino, J. Sakai, N. Noguchi, K. Tsubaki, and H. Hirayama, "Deep-ultraviolet light-emitting diodes with external quantum efficiency higher than 20% at 275 nm achieved by improving light-extraction efficiency," Appl. Phys. Express, vol.10, 031002, 2017.
- 23 Y. Narukawa, M. Ichikawa, D. Sanga, M. Sano, and T. Mukai, "White light emitting diodes with super-high luminous efficacy," J. Phys. D: Appl. Phys., vol.43, 354002, 2010.
- 24 G.-D. Hao, S. Tsuzuki, and S. Inoue, "Small valence band offset of h-BN/Al₀₇Ga₀₃N heterojunction measured by Xray photoelectron spectroscopy," Appl. Phys. Lett., vol.114, 011603, 2019.



井上振―郎 (いのうえ しんいちろう) 未来 ICT 研究所 深紫外光 ICT デバイス先端開発センター センター長 博士 (工学) ナノ光エレクトロニクス